

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2012 年 4 月 26 日(26.04.2012)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2012/053483 A1

- (51) 国際特許分類:  
*C08L 53/00* (2006.01) *C09D 109/06* (2006.01)  
*C09D 5/00* (2006.01) *H05K 3/28* (2006.01)  
*C09D 7/12* (2006.01) *H01L 21/312* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/073846
- (22) 国際出願日: 2011 年 10 月 17 日(17.10.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2010-237476 2010 年 10 月 22 日(22.10.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 昭和電工株式会社(SHOWA DENKO K.K.) [JP/JP]; 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目 1 3 番 9 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大賀 一彦 (OOGA, Kazuhiko) [JP/JP]; 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目 1 3 番 9 号 昭和電工株式会社内 Tokyo (JP). 東 律子(AZUMA, Ritsuko) [JP/JP]; 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目 1 3 番 9 号 昭和電工株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 青木 篤, 外(AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎

ノ門 3 7 森ビル 青和特許法律事務所 Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: MOISTURE-PROOF INSULATING MATERIAL

(54) 発明の名称: 防湿絶縁材料

(57) Abstract: Provided are: a moisture-proof insulating material having superior long-term insulating reliability and adhesiveness to polyimides and glass substrates, and has a solid content concentration that can secure a thickness that realizes sufficient moisture-proof performance after application and drying in a viscosity region that can be easily coated by means of a dispenser; and an electronic component that has been insulation-processed by means of the moisture-proof insulating material. The moisture-proof insulating material contains a styrene-based thermoplastic elastomer, a tackifying agent, and a solvent, and is characterized by the solvent containing an aliphatic hydrocarbon solvent (for example, methylcyclohexane or cyclohexane) having a boiling point that is at least 80°C and less than 110°C. The solvent preferably further contains an aliphatic hydrocarbon solvent (for example, ethylcyclohexane or dimethylcyclohexane) having a boiling point that is at least 110°C and less than 140°C.

(57) 要約: ディスペンサーにより容易に塗布可能である粘度範囲において、塗布・乾燥後に十分な防湿性能を発現する厚みが確保できる固形分濃度であり、かつ、ガラス基材やポリイミドへの密着性および長期絶縁信頼性に優れた防湿絶縁材料、および該防湿絶縁材料によって絶縁処理された電子部品を提供する。スチレン系熱可塑性エラストマー、粘着付与剤、および溶媒を含む防湿絶縁材料であって、前記溶媒が 80°C 以上 110°C 未満の沸点を有する脂肪族炭化水素系溶媒 (例えば、メチルシクロヘキサン、シクロヘキサン) を含むことを特徴とする。前記溶媒は、好ましくは、さらに 110°C 以上 140°C 未満の沸点を有する脂肪族炭化水素系溶媒 (例えば、エチルシクロヘキサン、ジメチルシクロヘキサン) を含む。

WO 2012/053483 A1